

3719-1**4.5" x 6.5"**

Circuit Pattern:
Contacts:

Contacts Only
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

6.50"/.062"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

50

Material:

CEM-1

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-4

Rec. Card Cage:

Series 13

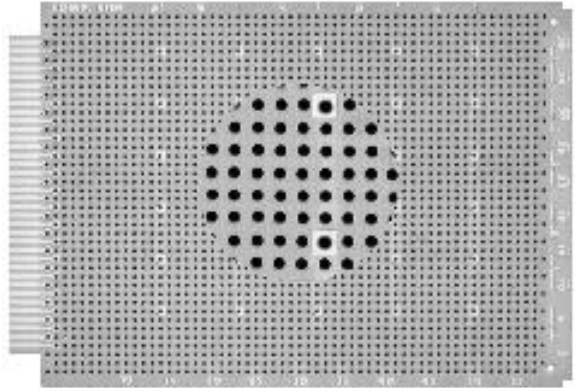
Wire-Wrap Connector:

R636-1

Hole Diameter:

.042"

- Unrestricted component placement over entire board surface
- Layout paper and instructions included
- Row and column legends provided

**3719-6****4.5" x 6.5"**

Circuit Pattern:
Contacts:

Pad-Per-Hole
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

6.50"/.062"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

40

Material:

FR4 Epoxy Glass

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-4

Rec. Card Cage:

Series 13

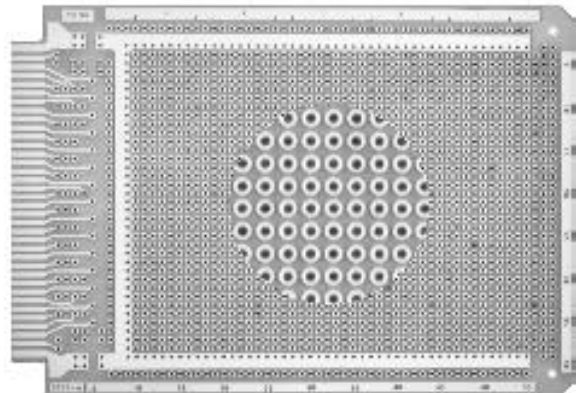
Wire-Wrap Connector:

R644-1

Hole Diameter:

.042"

- 0.080" diameter, isolated solder pad around holes, plated-thru holes
- Low resistance, etched peripheral bus pattern
- Pad and bus surfaces solder-coated for user convenience
- Convenient, easy-to-read hole marking legend on board surface
- Layout paper and instructions included

**4066-4****4.5" x****6.5"**

Circuit Pattern:
Contacts:

Ground Plane/
Interleaved Buses
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

6.50"/.062"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

34

Material:

CEM-1

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-4

Rec. Card Cage:

Series 13

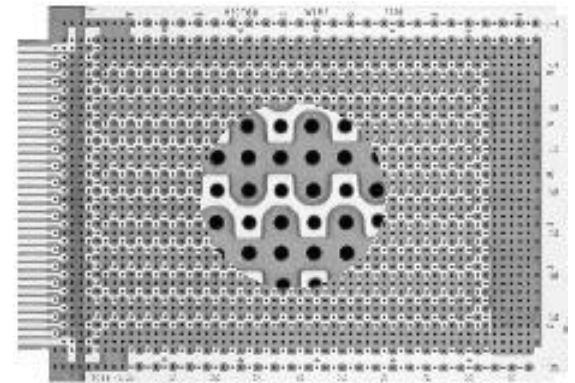
Wire-Wrap Connector:

R636-1

Hole Diameter:

.042"

- Overall ground plane on wiring side; etched, interleaved zig-zag bus pattern on component side provides three bus lines for ECL circuitry
- 0.085" etched clearance area around each hole on ground plane side
- Bus and plane surfaces solder-coated for user convenience
- Layout paper and instructions included

**3719-4****4.5" x 9.6"**

Circuit Pattern:
Contacts:

Contacts Only
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

9.60"/0.62"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

90

Material:

CEM-1

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-2

Rec. Card Cage:

Series 14

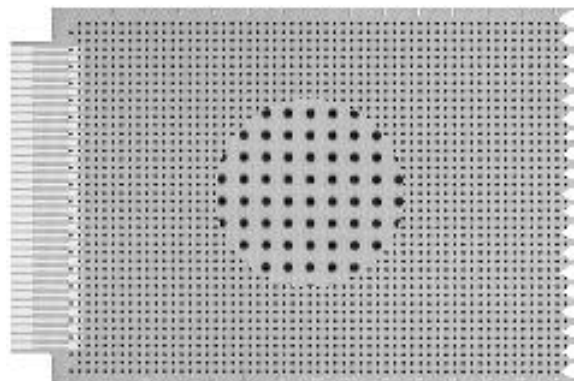
Wire-Wrap Connector:

R636-1

Hole Diameter:

.042"

- Unrestricted component placement over entire board surface
- Row and column legends provided
- Layout paper and instructions included



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9